

证券代码：688233

证券简称：神工股份

锦州神工半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-009

投资者关系 活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒一对一沟通 ☒其他（电话会议）
---------------	---

二、公司业绩的趋势性变化

分析2025年上半年数据，公司管理层关注以下趋势性变化：

第一，公司主力业务大直径硅材料的毛利率仍然稳定，继续保持着领先的盈利能力；第二，公司成长型业务硅零部件占公司总营收的比重已经超过了大直径硅材料，毛利率稳中有升，公司第二增长曲线进一步强化；第三，迅速发展的硅零部件业务将带动公司自产大直径硅材料的出货量，公司“从硅材料到硅零部件”的一体化生产优势逐渐显现，因此公司业绩的“成长性”特征日益突出。

三、硅片业务的行业环境变化

公司注意到，半导体硅片产业在因时而变。在8吋轻掺抛光硅片领域，具备全球竞争优势和寡头垄断地位的日本厂商，正在将更多产能调配至12吋轻掺抛光硅片，以在不额外增加资本开支的前提下，改善其盈利能力。

考虑到中国本土8吋轻掺硅片的潜在市场需求仍然存在增长，日本厂商的动向有望扩大国产化空间。公司作为国内少数具备8吋轻掺抛光硅片技术和生产能力的企业，有望在行业供求关系的变动中，发挥自身独特技术优势，优化变动成本，改善竞争地位。

公司已于第二季度开始投入资源，针对下游评估的实际需求，小幅增加硅片生产量。

四、硅零部件业务的扩产进度

土地、厂房、设备等生产要素的整備只是基础条件，“人机结合”更为关键，乃是一项系统工程。经过过去数年的连续扩产，该业务目前对公司的管理效率提出了更高要求乃至挑战。扩产的质量和扩产的速度需要保持最佳平衡，才能保障公司持续健康发展。

因此，公司将以下游客户订单为基础扩大产能，努力保持良率及毛利率水平，继续保持以高端产品为主的销售结构，满足中国本土硅零部件国产化的需求。

上半年，公司的硅零部件产能扩张方针“稳”字当头，毛利率稳中有升，取得良好成效。

附件清单	无
日期	2025 年 9 月 26 日